

河北迈芯维全倒装COB刺晶工艺

产品名称	河北迈芯维全倒装COB刺晶工艺
公司名称	深圳市康普信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3
联系电话	0755-21038002 18565839923

产品详情

传统式的芯片迁移技术全部采用Pick&Place的形式，MiniLED因其芯片尺寸低于200 μm，而Pick&Place模式中，真空吸盘的直径很难做到200um之内，再加上MiniLED对快速的需求，每一个传统式处理芯片迁移方式和机器设备都难以为MiniLED的批量生产服务项目。深圳康普信息科技有限公司选用部分倒装COB的刺结晶计划方案，完全抛下真空吸盘，与此同时大大提高处理芯片迁移速率。